

高通 CES 車用戰略全展開 亞馬遜、Garmin 等十項合作案吸睛

資料蒐集：太報

晶片大廠高通 CES 展，在 PC、智慧家庭、企業級物聯網、AI 戰略全面展開，更找來科技巨頭聚焦車用應用合作，包括：亞馬遜、Garmin、Alps Alpine 等廠商，宣布了基於 Snapdragon 數位底盤解決方案的近十項最新合作進展，涵蓋數位座艙、智慧駕駛、兩輪車等多個領域。藉由生成式 AI、高效能運算和先進連接技術。

高通和亞馬遜重新定義以 AI 驅動的車內體驗。本次技術合作的目標是加速先進 AI 技術在車輛中的整合，使汽車製造商、開發人員和供應商能夠實現創新且豐富的車內體驗，同時降低開發時間和成本。先進汽車體驗預計將運用更高效能的大型語言模型和 Snapdragon 座艙平台內建的強大神經處理單元。

Garmin 與高通推出搭載 Snapdragon Cockpit Elite 平台的新一代數位座艙解決方案。全新 Garmin Unified Cabin 2025 採用高效能的 Snapdragon Cockpit Elite 平台，支援 AI 加速的頂級車內體驗。雙方開發具有中央網域控制器功能的可擴展數位座艙解決方案。

而 Alps Alpine 攜手高通，基於支援生成式 AI 功能的第四代 Snapdragon 座艙平台，共同推出新一代數位座艙解決方案，推動感測器整合、連接解決方案、安全性和舒適性在汽車產業的全面提升。

Hyundai Mobis 將 Snapdragon Ride Flex SoC 和 Snapdragon Ride 自動駕駛軟體疊層，與其尖端的軟體和感測器相結合，打造下一代高效能運算平台。

零跑汽車（Leapmotor）方面，全新發布的零跑 B10 車型搭載第四代 Snapdragon 座艙平台，提供可客製的數位座艙和先進的語音助理功能；同時搭載 Snapdragon Ride 平台，支援先進駕駛輔助系統（ADAS）和智慧駕駛功能，包括高速及城市自動輔助導航駕駛（NOA）。

馬亨達（Mahindra）則於 2024 年 11 月推出的首批電動 SUV 採用了 Snapdragon 數位底盤解決方案，這象徵著第四代 Snapdragon 座艙平台和 Snapdragon 汽車 5G 數據機射頻解決方案首次在印度市場落地。

Panasonic Automotive 的全新座艙網域控制器和高效能運算系統將採用高通的多代 Snapdragon 座艙平台，包括全新 Snapdragon Cockpit Elite，加速開發雲端連接資訊娛樂系統。

至於皇家恩菲爾德（Royal Enfield）旗下全新電動車品牌 Flying Flea，也宣佈與

高通合作，在其未來推出的電動摩托車中採用 Snapdragon QWM2290 SoC 和 Snapdragon 車對雲服務。